

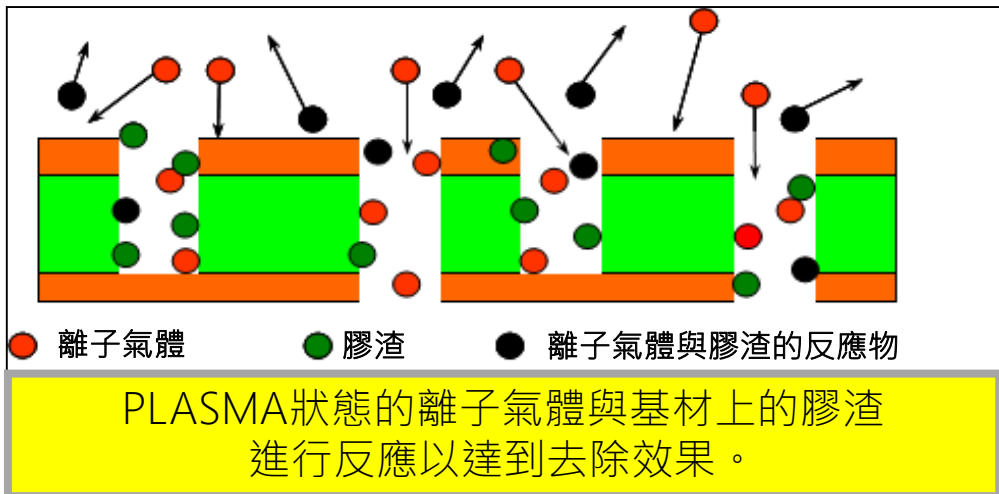


JCU PLASMA處理装置
TAIKAI

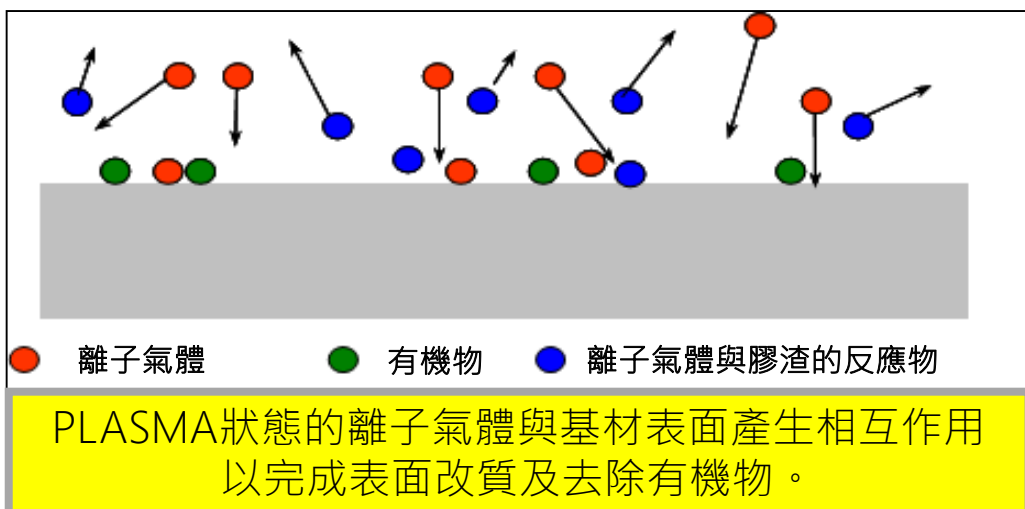
株式会社 JCU

何為PLASMA處理

表面改質 · 表面清潔



去膠渣 · 去殘膠



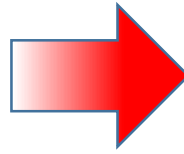
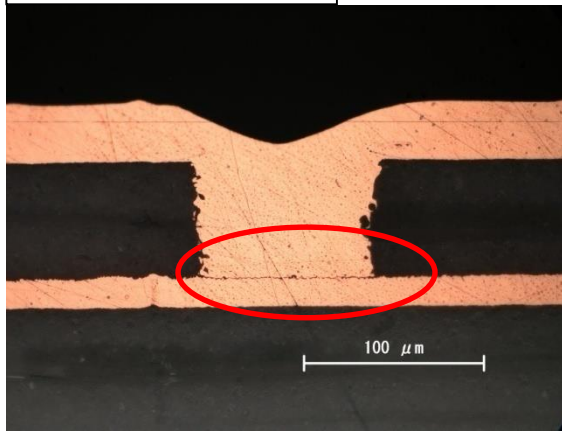
主要氣體種類與使用目的

- O_2 : 有機氧化
- Ar : 物理蝕刻
- H_2 : 去氧化 (還原)
- $CF_4 + O_2$: 高速灰化

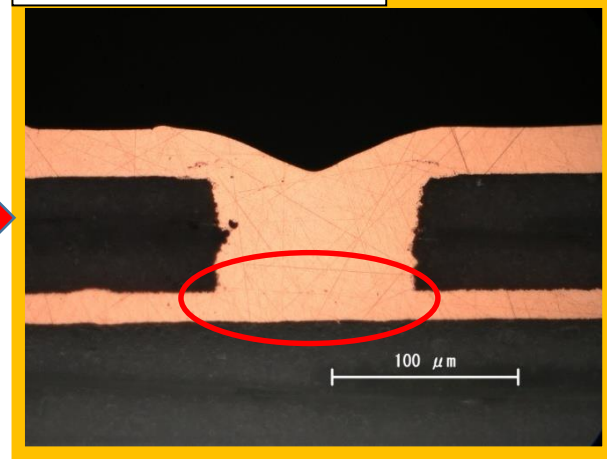
乾式除膠渣 (盲孔)

電鍍後斷面

PLASMA未處理

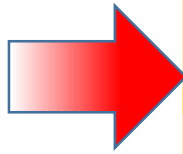
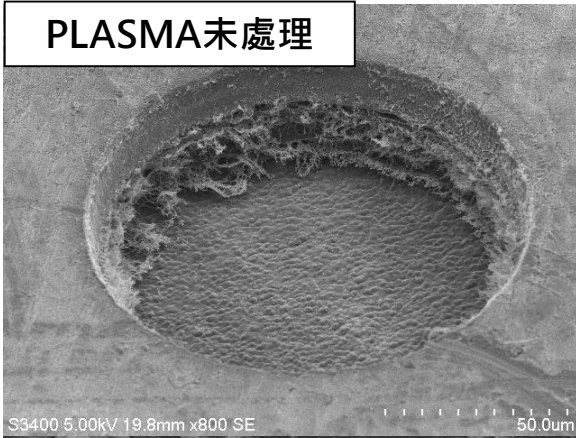


PLASMA處理後

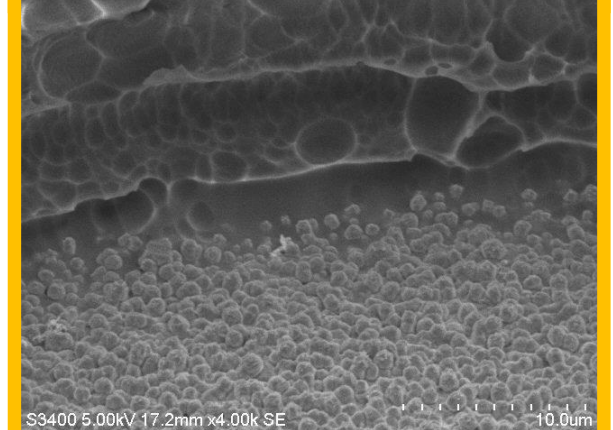
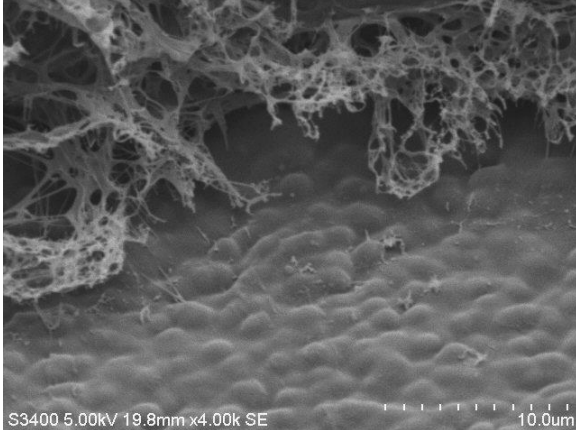
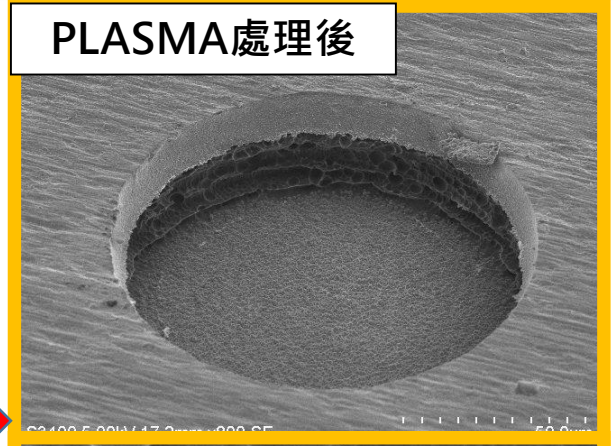


SEM觀察

PLASMA未處理



PLASMA處理後

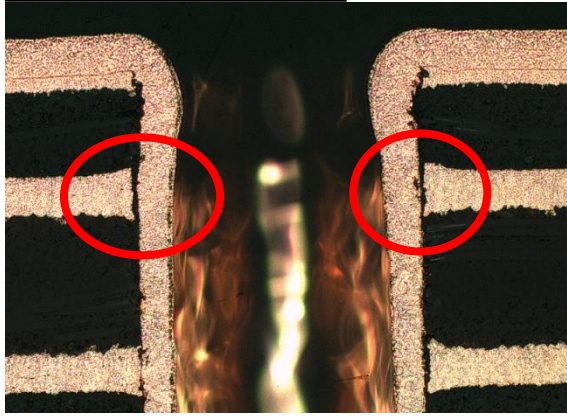


通過清除盲孔內部膠渣
確保電鍍可靠性！

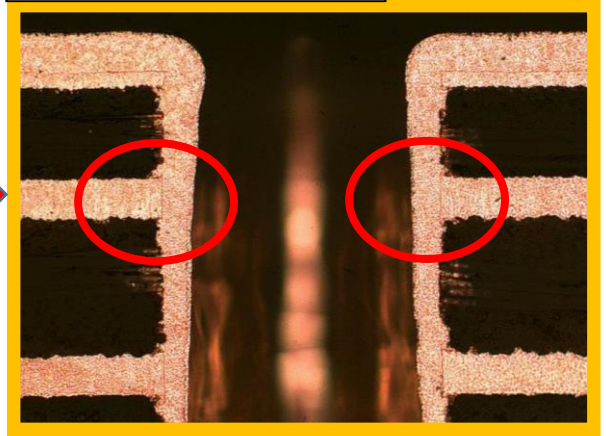
乾式除膠渣（通孔）

電鍍後斷面

PLASMA未處理

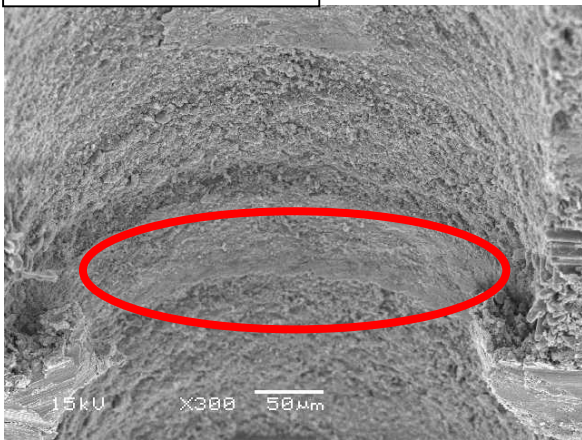


PLASMA處理後

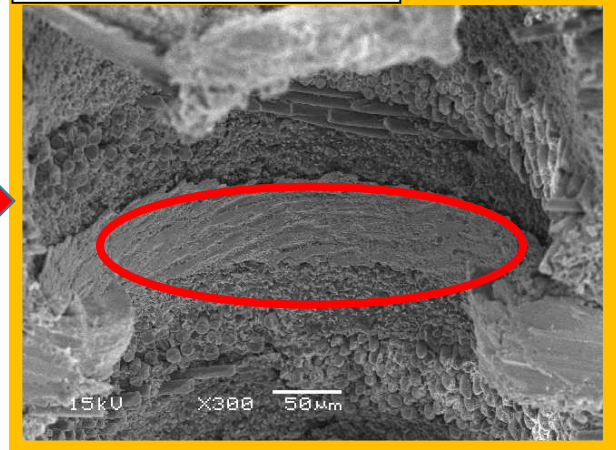


SEM觀察

PLASMA未處理

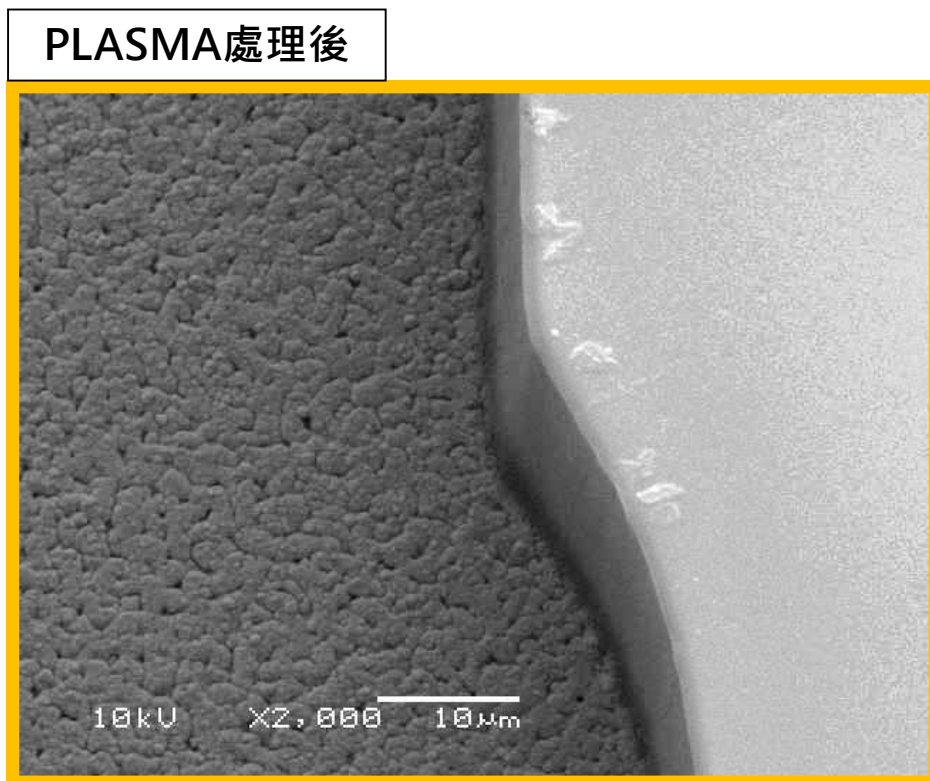
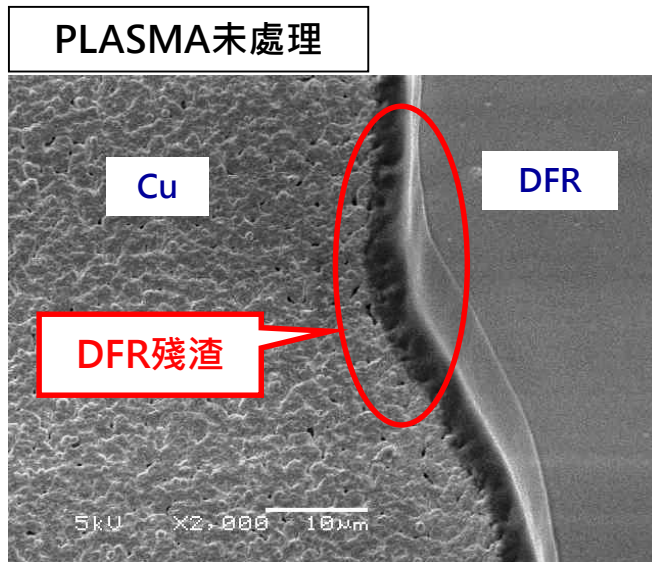


PLASMA處理後



通過清除通孔內部膠渣
確保電鍍可靠性！

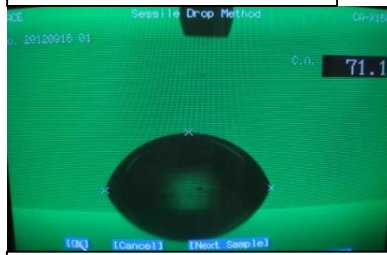
乾式除殘膠



通過乾膜光阻殘渣的去除
形成精細線路！

表面改質 (親水化處理)

PLASMA未處理



接觸角 : 71.1°



PLASMA處理後

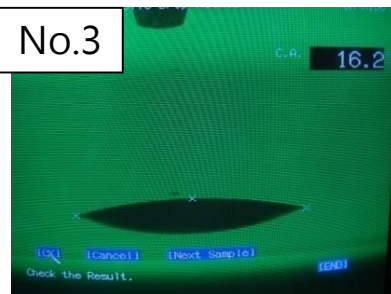
No.1



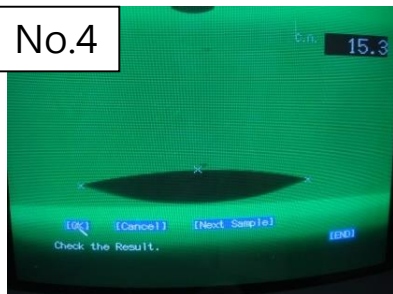
No.2



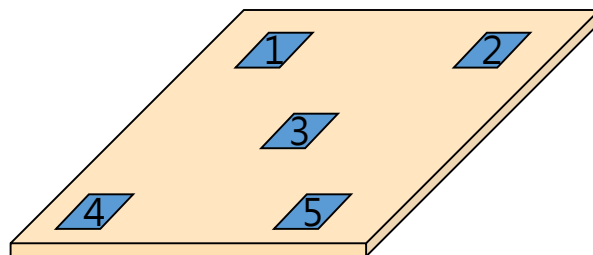
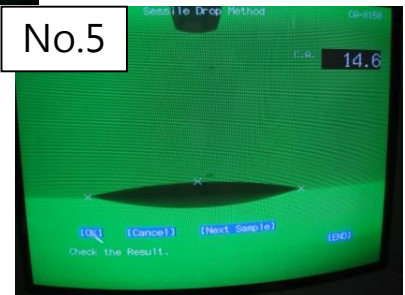
No.3



No.4



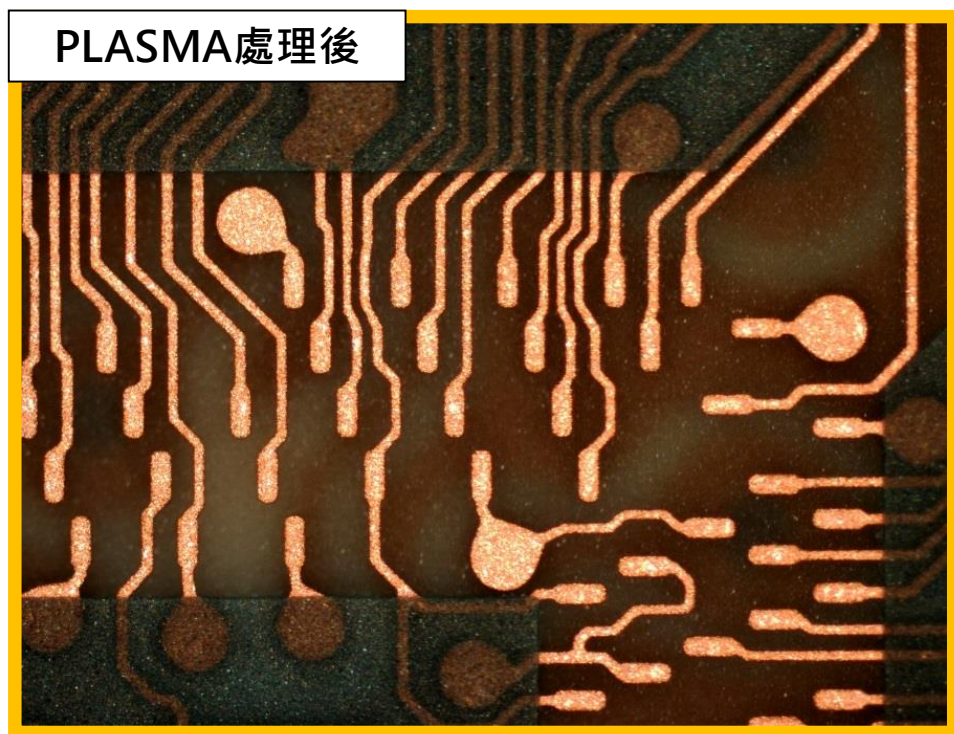
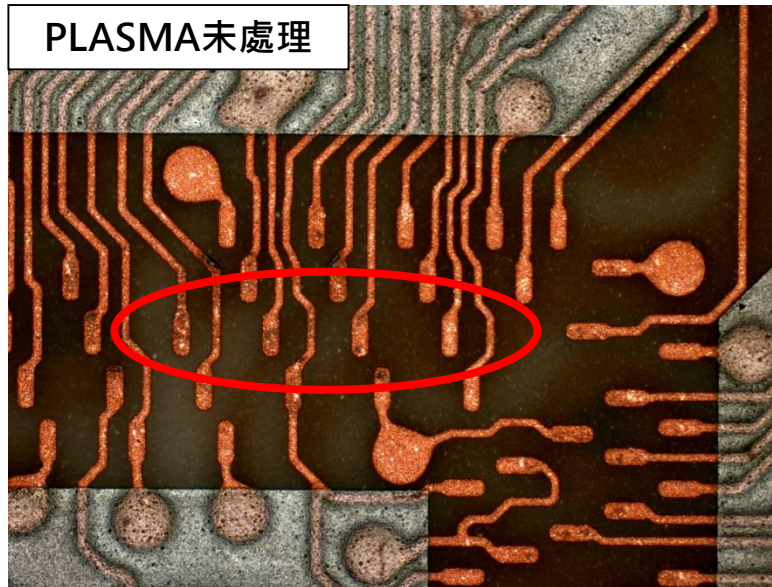
No.5



通過在樹脂/金屬上形成親水基團、
使電鍍液可以均勻地浸透至基材的微細線路內！

表面清潔

去除金屬 (Cu) 上的有機物殘渣



有效改善電鍍金等後處理製程的良率

TAIKAI LINE-UP

垂直處理式設備



片式自動運輸設備



卷對卷式自動運輸設備



研究開發用小型機



裝置特長

垂直處理式設備

- 可同時處理複數基板、生產效率高。
- 透過使用可變治具、可處理各種尺寸基板。

片式自動運輸設備

- 採自動運輸對應、減少人為失誤的發生。
- 基板一枚處理、面內均一性程度高。

卷對卷式自動運輸設備

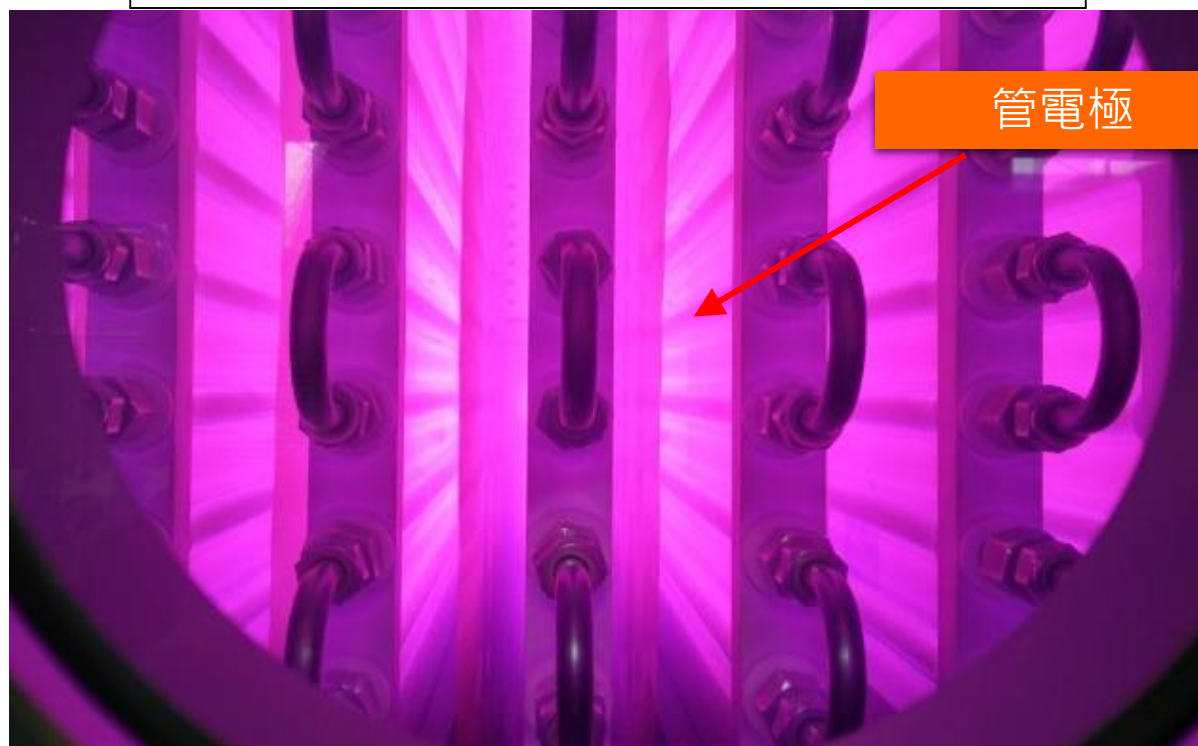
- 不切斷FCCL卷材、可進行連續處理。
- 透過低溫下的高速蝕刻、完成除膠渣、除殘膠工程。

研究開發用小型機

- 經濟且節省空間。
- 適合少量生產及開發用途的PLASMA處理。

電極特長

PLASMA放電過程中的腔體內部情況



管電極

- 通過管電極使電極內部的壓力分佈均勻。
- 通過使冷卻水流過電極的方式，可於低溫下進行 PLASMA處理。
- 腔體及電極皆採用放電效率高的金屬材料。

可適用於各種基材的PLASMA處理！

台灣傑希優股份有限公司

338 桃園市蘆竹區長榮路191號

電話：+886-3-312-0728

傳真：+886-3-312-0280

服務信箱：service-tw@jcu-i.com